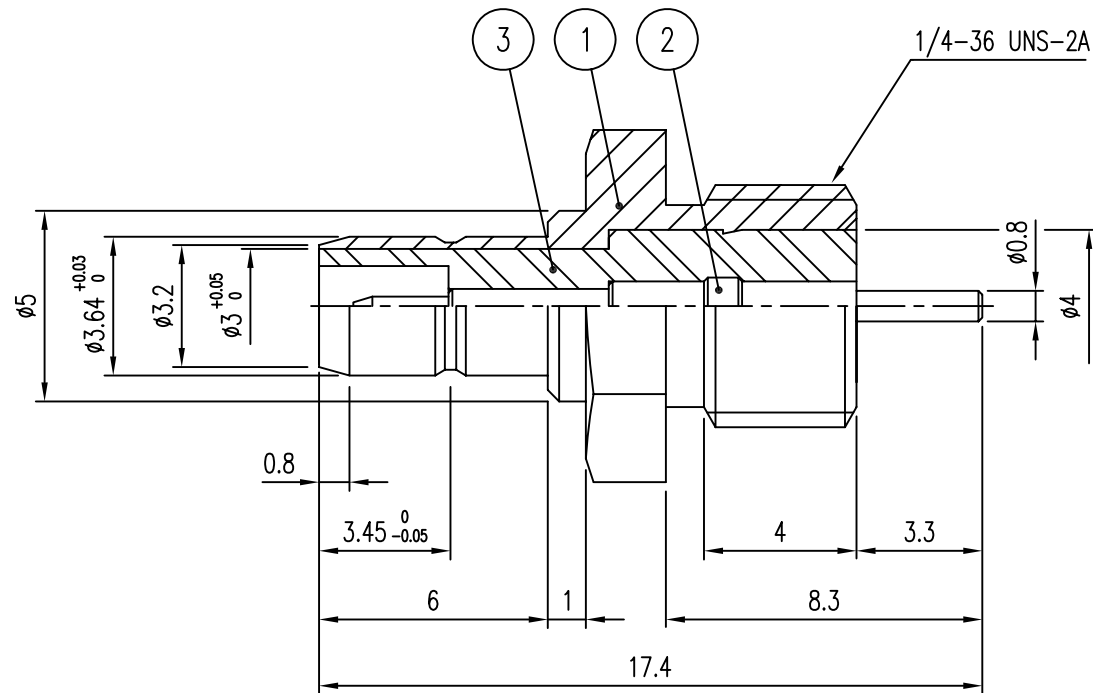


가공	1	2	3	4	수 정 내 용			
ST					부호	내 용	수정자	승인자
ST(기초)					1	[첨변No.201806-0001] 조립상 개신으로 인해 배다 넘시배늘 추가	은선영	김인철
ST(개선)								년 월 일
								2018. 06. 04.



3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00315-N/1 (H3077)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00899-5/1 (E3081)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00499-5/1 (D3085)
대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리

공통공차	년월일	1999. 12. 20.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
.* ±0.1 .** ±0.05	승인				
재질	검도		도명 SMB50 SOLDER END JB (F/F)		
열처리	재도				
보호피막처리	작성부서	연 구 소	A4		
	척도 5/1	단위 mm			
	중량		도번 CN00200-7/1		
			K315-512-000		